公益社団法人精密工学会
プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会
第214回研究会開催のご案内

日時：2024 年 4 月 25 日（木）
13:00～19:00
17:00～ 情報交換会

このたび、プラナリゼーション CMP 専門委員会では、下記の通り『半導体技術開発の歴史、イノベーション、そして未来に向けて』のテーマにて、第214回研究会を開催いたします．会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています．また，非会員の方のご参加も有料にて受け付けております．是非ご参加下さい．

開催場所：プラザエフ（JR 四ッ谷駅麹町口から徒歩1 分）
東京都千代田区六番町 15（TEL：03-3265-8111）

※オンサイトのみの開催となります。
※開催日2日前の4月23日午前中までに参加登録をお願い致します。

プログラム：
13:00～ 13:10　開会挨拶（黒河委員長）

13:10～ 16:45　話題提供

テーマ：『半導体技術開発の歴史、イノベーション、そして未来に向けて』

（森永幹事、和田幹事）

13:10～ 13:15　主旨説明　（森永幹事）

1）13:15～14:30 ＜基調講演＞
「半導体産業をめぐる経済をどうとらえるか？ 半導体関連技術が目指す方向は？ 製造業で働くとは？」
広島大学　青砥 なほみ　氏

＜概要＞ 次のテーマについてお話しする。（1）世界・日本の半導体をめぐる経済・技術の状況について最新の経済統計データ等に基づき検討する。その中で、経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」において出発点に用いられる資料を見直し、我々が一般常識としている情報を検証して、より的確な現状認識に近づく。（2）半導体デバイス開発のイノベーションの例を紹介する。その上で半導体と AI をめぐる最新の予測データに基づいてエネルギー消費の問題を検討し、半導体関連技術が進むべき方向を考える。（3）製造業で働くとは？などにつき、講師の経験に基づく考えを、製造業で活躍する皆さんに語る。

2）14:30～15:10
「シリコン（Si）結晶ウェーハ加工技術の30年間の変遷とこれからへの若手へのメッセージ」
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社　泉妻　宏治　氏

＜概要＞ Si ウェーハの市場で日本企業が全世界で約 70%シェアという強い理由について、主に技術的な側面から、①製造技術のノウハウ、②80 年代からの日本の半導体市場、③技術の伝承であると考えている。それぞれについて、これまでの 30 年間の技術の変遷から考察する。さらに、本格的な AI 技術を迎えて次世代半導体デバイスが必須となっており、将来、日本の Si ウェーハ企業が発展するには、モノづくり改革、新しい融合、および技術の伝承の継続が重要となる。若手の方々にこれからも世界で戦うためのメッセージを伝えたいと思います。

……
15:10～15:25　休憩
……

3）15:25～16:05「ウェハ用枚葉洗浄技術の最近の動向と環境を考慮した未来への取り組み」
芝浦メカトロニクス株式会社　神保　定之　氏

＜概要＞ ウェハ製造の洗浄工程において、品質向上を目的に枚葉化が進んでいる。本講演では、研磨後ウェハの洗浄工程において、洗浄フローを示しながら各ステップの役割を説明する。また、プロセス条件による洗浄性能の制御性向上など、枚葉化のメリットを説明する。近年、半導体製造においても環境負荷低減が求められている。当社では環境を考慮した洗浄技術の開発も行っており、その内容を紹介する。

4）16:05～16:45 「半導体業界の「共創」担うレゾナックの戦略」

株式会社レゾナック　阿部　秀則　氏

＜概要＞ 昭和電工と昭和電工マテリアルズ（旧日立化成）の統合新会社であるレゾナックは、共創型化学会社を目指し、社会課題である半導体の性能向上に努めている。本講演では最先端半導体パッケージング技術開発を加速するため、国内外の材料・基板・装置メーカーとの共創事例として J0INT2 や海外戦略を紹介する。

16:45～ 17:00　連絡事項・閉会挨拶

17:00～　　情報交換会（プラザエフ 8F「スイセン」）

参加費（オンサイトのみ）

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円）　※会場参加：2 名まで無料、3 名以上の場合 ¥3,000/名
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）

※ご入会検討でお試し参加される場合，初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます.

※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します.

2024 年 4 月 25 日（木）開催　第 214 回　研究会　参加申込書

氏　名				
勤務先・所属				
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			

※ホームページからオンライン申し込みできます。

http://www.planarization-cmp.org/registration

問合せ先：「プラナリゼーション CMP 専門委員会」事務局（中村）
TEL：03-5962-3145，FAX：03-5962-3146，E-mail：nakamura@global-net.co.jp